



2014年9月3日

各 位

会社名 日本ガイシ株式会社
 (登記社名 日本碍子株式会社)
 代表者名 代表取締役社長 大島 卓
 (コード番号 5333 東証・名証各第1部)
 お問い合わせ先 財務部長 神藤 英明
 (TEL 052-872-7230)

日鉄住金エレクトロデバイス株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

当社は本日、新日鐵住金株式会社（代表取締役社長：進藤孝生、本社：東京都千代田区）との間で、同社の完全子会社でセラミックパッケージなどの電子工業用セラミックスを製造・販売する日鉄住金エレクトロデバイス株式会社（代表取締役社長：中島英雅、本社：山口県美祢市）の全株式を取得する契約を締結しましたのでお知らせいたします。

1. 株式取得の理由

当社はトリプルE（エネルギー、エコロジー、エレクトロニクス）を事業領域としており、電子部品事業のセラミックパッケージは今後の成長分野の一つであると考えております。

日鉄住金エレクトロデバイスはセラミックパッケージやパワーデバイス用基板、アクチュエーター用圧電部品などを製造・販売する電子工業用セラミックスメーカーです。中核事業のセラミックパッケージは、パソコンやモバイル機器、デジタル家電、携帯通信基地局、光通信システムにおいて水晶デバイスや高周波デバイス、光通信デバイスを実装するために必要不可欠な基幹部品です。

情報通信機器の多機能・高性能化や自動車のエレクトロニクス化などに伴い、持続的な市場拡大が見込まれるほか、搭載機器の小型・薄型化の進展により、部品の小型・低背化や高精度・高性能化への要求がますます高まっております。

同社が長年培ってきた製造ノウハウや多品種・低コスト量産技術に、当社の材料技術や高精度プロセス技術を付加することで、両社の保有技術のシナジーを創出し、当社のエレクトロニクス事業のさらなる成長を図ることができると判断し、同社株式の取得による子会社化を決定いたしました。

2. 異動する子会社の概要

(1) 名 称	日鉄住金エレクトロデバイス株式会社
(2) 所 在 地	山口県美祢市大嶺町東分 2701-1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 中島英雅
(4) 事 業 内 容	半導体用セラミックパッケージ、セラミック製電子部品の製造・販売
(5) 資 本 金	34億5,000万円
(6) 設 立 年 月	1991年3月
(7) 大株主および持株比率	新日鐵住金株式会社 100%
(8) 従 業 員 数	単独500人、連結2,314人（2014年3月末現在）
(9) 主 な 事 業 所	本社工場（山口県美祢市）、東京営業本部（東京都千代田区）、 尼崎事業所（兵庫県尼崎市）、マレーシア・ペナン、中国・蘇州
(10) 連 結 売 上 高	245億円（2014年3月期）

3. 株式取得の相手先の概要

(1) 名 称	新日鐵住金株式会社
(2) 所 在 地	東京都千代田区丸の内 2-6-1
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 進藤孝生
(4) 事 業 内 容	製鉄事業、エンジニアリング事業、化学事業、新素材事業、システムソリューション事業
(5) 資 本 金	4,195 億円
(6) 設 立 年 月	1950 年 4 月
(7) 従 業 員 数	単独 24,152 人、連結 84,361 人 (2014 年 3 月末現在)
(8) 連 結 売 上 高	5 兆 5,161 億円 (2014 年 3 月期)

4. 日 程

(1) 株式譲渡契約書締結	2014 年 9 月 3 日
(2) 株式譲渡実行	2015 年 1 月 5 日 (予定)

5. 今後の見通し

本株式取得による 2015 年 3 月期の連結業績への影響は軽微な見込みです。

以 上